

Obróbka Obwodów Drukowanych

Walki szlifujace Typu SVL



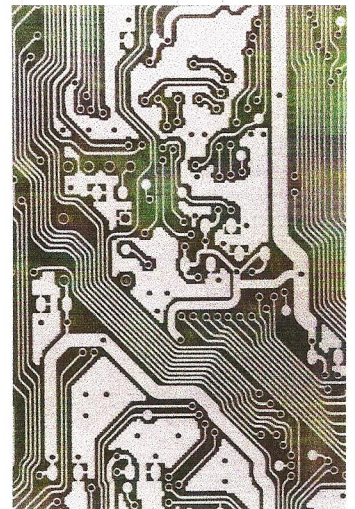
Zastosowanie:

- Gradowanie
- Czyszczenie przed sitodrukiem i fotodrukiem
- Czyszczenie mechaniczne przed soldermaska
- Czyszczenie blach stosowanych w procesie produkcji płyt wielowarstwowych
- Obróbka końcowa

Bardzo długa żywotność zapewniona przez specjalną impregnację "I1", "I2" oraz "I1-A"

Pracując z naszymi walkami będziecie mogli dostrzec następujące korzyści:

- Optymalna krawędź otworu (utrzymuje się geometria wywierconych otworów)
- Bardzo dobra i stała skuteczność usuwania gradów
- Odpowiednia szorstkość na powierzchni płytki
- Stały tryb pracy
- Optymalne wyważenie zapewniające dużą oszczędność kosztów maszyn
- Na krawędziach otworów nie pozostają mikro-włoski tkaniny walków
- Odpowiednia szorstkość podczas trwania całego procesu



Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny

zapewniając jednocześnie

dużą wydajność naszych produktów